



2026年3月31日

各 位

会社名 伯東株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 宮下 環
(コード:7433、東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員
コーポレートインテリジェンスユニット
ユニットマネージャー 海老原 憲
(TEL 03-3225-8910)

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(最新版)

当社は、2024年4月30日に公表しました「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」のアップデートを目的に見直しを行い、この度2026年3月31日開催の取締役会において、その方針について決議いたしましたので、別紙内容の通りお知らせいたします。

以 上

資本コストや株価を意識した 経営の実現に向けた対応について

伯東株式会社

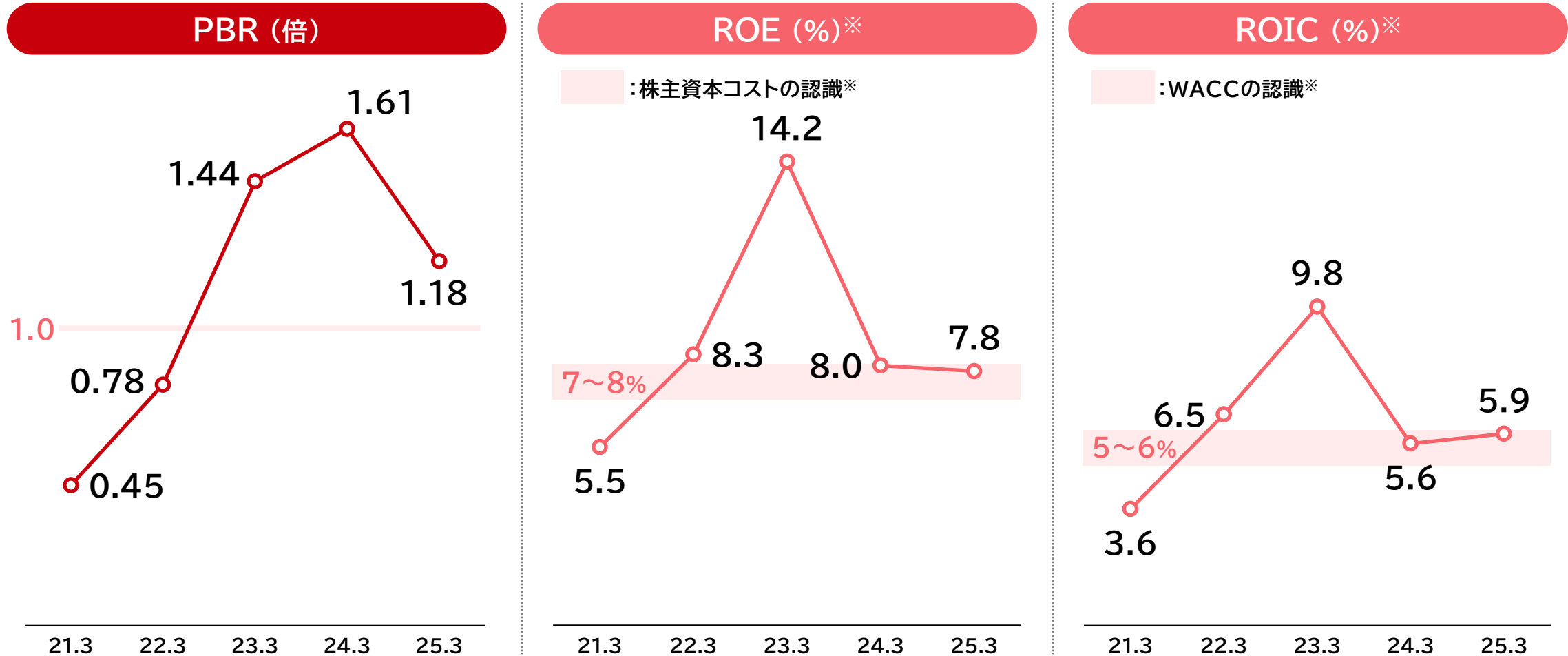
2026年3月31日



東証プライム市場 | 証券コード7433

資本市場における当社の現状認識

足元PBRは1倍超もROEは7.8%、ROICは5.9%と、株主資本コスト、WACCの認識と同水準。
 持続的な企業価値向上に向けては、資本効率を意識したROE改善が必要

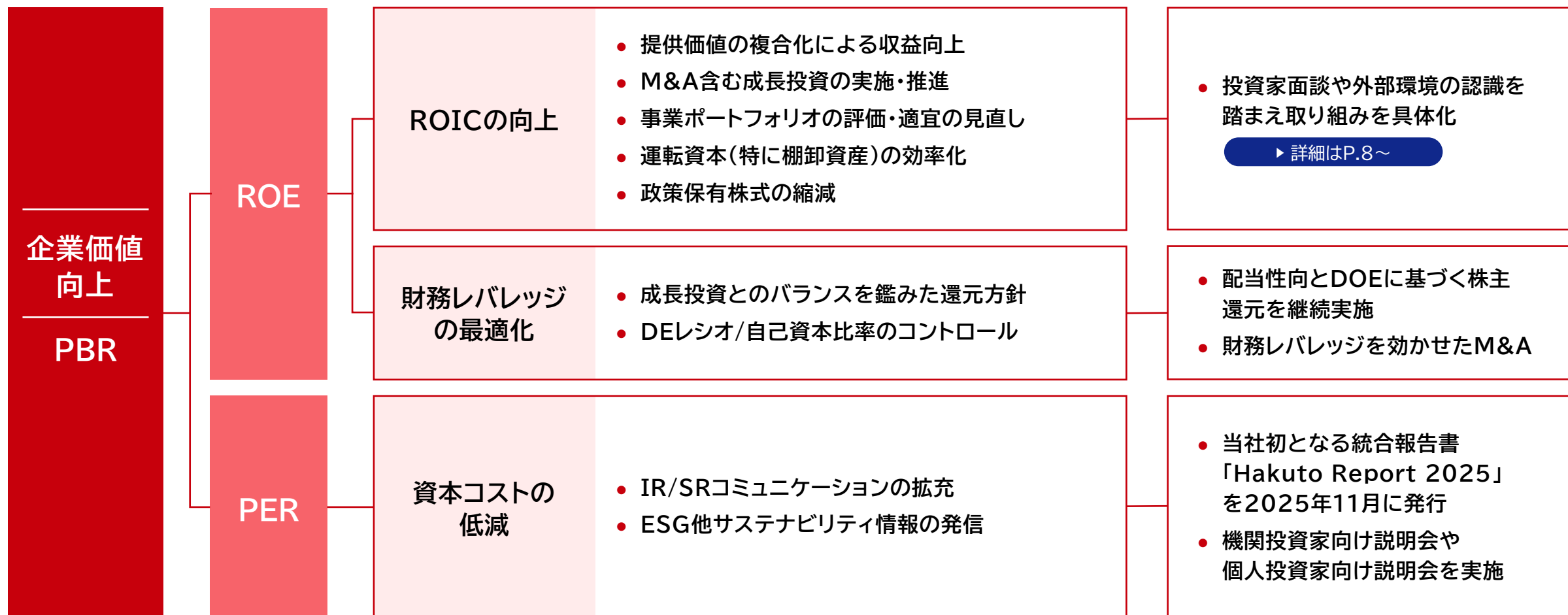


※ ROEは当期純利益/自己資本、ROICは(営業利益×(1-実効税率))÷投下資本(投資その他の資産を含む固定資産+運転資本)で算出。自己資本、投下資本は期中平均。株主資本コスト、WACCはCAPMに基づく

「中期経営計画 Hakuto 2028」にて掲げた経営方針に基づくROIC経営を推進中

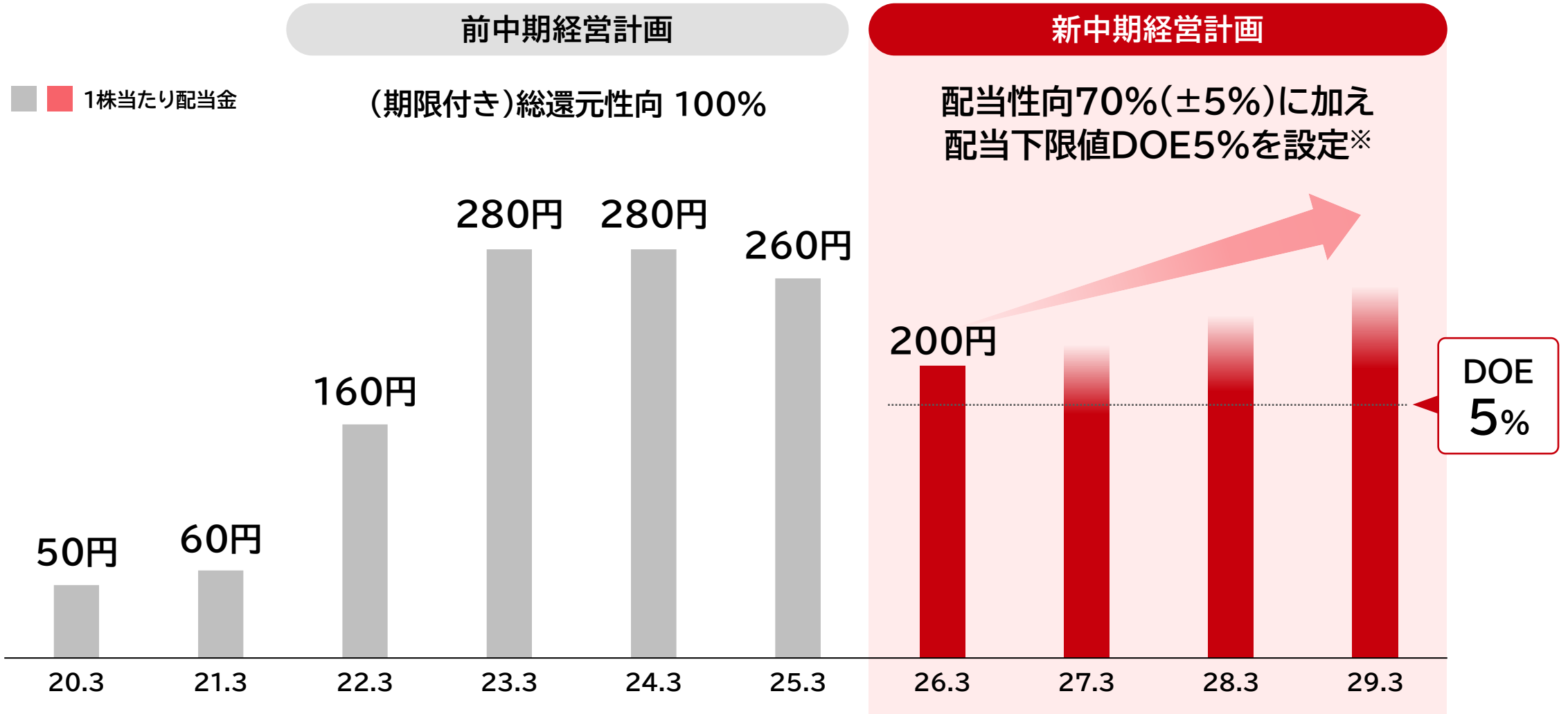
中期経営計画（2025年4月公表）の資本コスト経営方針

取り組み状況



財務レバレッジの最適化 ～株主還元方針

安定的な増配を目指し、配当性向70%程度に加え、DOE5%※の配当下限値を設定



※ DOE=純資産配当率

資本コストの低減 ～投資家エンゲージメント

統合報告書の公表をはじめ、各種IR/SRコミュニケーションを加速して推進中。投資家との対話を踏まえ、特に、資本効率の改善（在庫の圧縮）に係る打ち手の緊急度・重要度は高いと認識

統合報告書の発行



2025年11月に当社初となる
統合報告書を公表

Hakuto Report 2025

投資家・株主との対話実績（2025年度）

機関投資家との対話

36回

個人投資家向け説明会

会社説明会を実施
(2025年7月15日)

投資家・株主の関心ごと（抜粋）

■ 事業環境・成長戦略

- AI&先端半導体分野への取り組み状況は？
- 国内と海外、それぞれの事業環境は？
- M&Aの考え方、ターゲットは？

■ 資本効率改善に向けた取り組み

- 在庫回転期間は？在庫の変動要因は？
- 成長投資と還元のバランスの考え方は？
- 政策保有株式の考え方は？

活況な半導体市場は当社にとって追い風。ただし商社への期待は変化、改めて戦略方針が問われる

マクロ環境	
AI技術の普及・拡大	半導体の戦略物資化
石油&紙削減 環境意識高	人口減による 様々な自動化
世界的な 物価・資源高	自動車 100年に一度の変革
グローバルサウスの 成長加速	M&Aの活発化

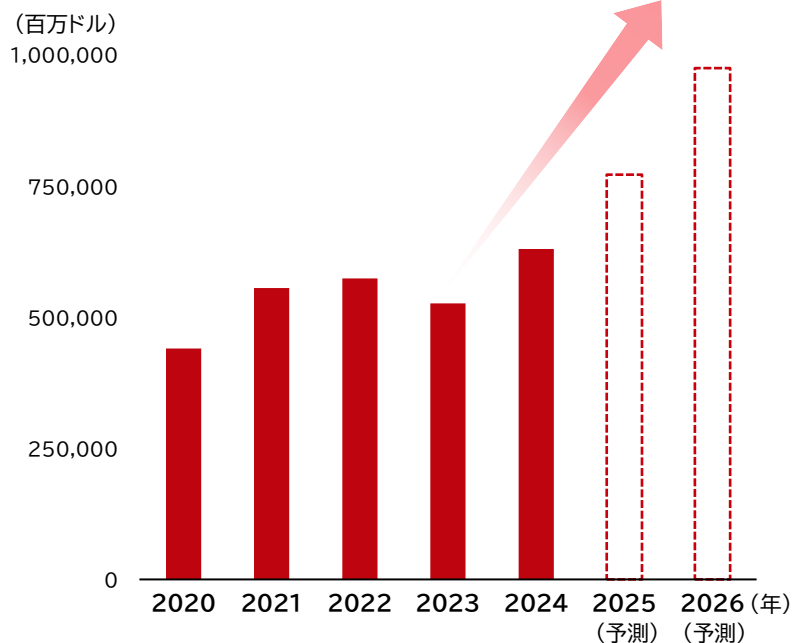
機会
半導体は引き続き高い成長率を維持 用途:車載・産機・各種インフラ等
国内外の半導体製造設備の投資に 引き続き高い期待感
代替エネルギー・環境対策(水・空気)領域で 新たなビジネス機会創出
リスク
<ul style="list-style-type: none">技術の進化による新たな競合の出現既存技術や価値のコモディティ化、陳腐化の進行半導体業界で求められる商社の役割・機能が変化。 その存在意義が改めて問われる

引き続きAI関連需要が半導体市場をけん引。経済成長に伴い、新興市場における需要も増加

AI需要が支える市場成長

市場成長のけん引役は生成AIからAIエージェントへ移行。需要の中心が個人向けから法人向けへ移る中、データセンター向け需要が増加

■ 世界半導体市場規模

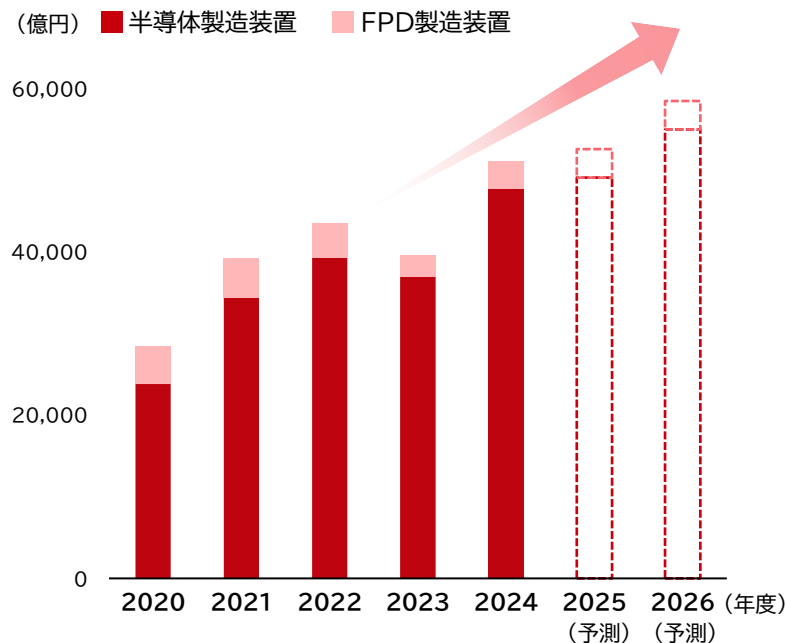


※ 出所:世界半導体市場統計(WSTS)

設備投資意欲の再加熱

AIサーバー以外の需要は鈍く投資は一服感が出ているものの、今後の回復期待やデータセンター向け需要の高まりから再び増加傾向へ

■ 日本製半導体/FPD製造装置販売高



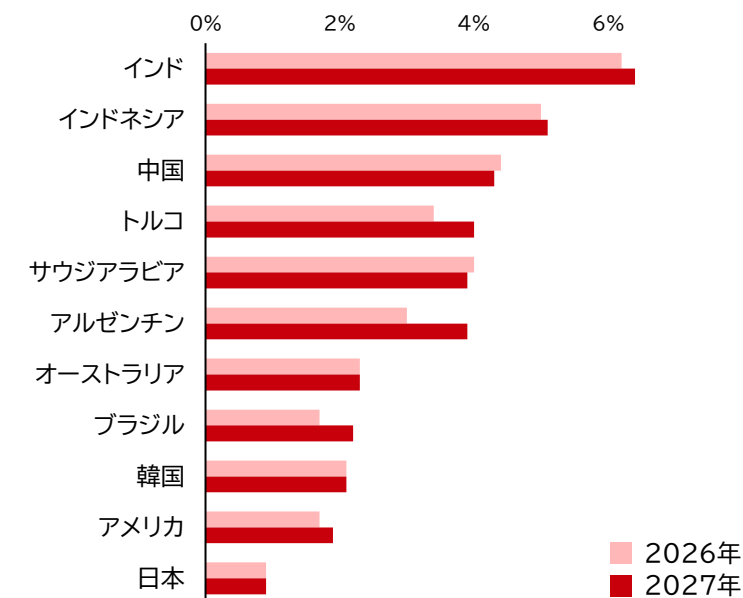
※ 出所:半導体・FPD製造装置 需要予測(一般社団法人日本半導体製造装置協会)

新興市場の成長加速

インドやインドネシア、中国などアジア諸国を筆頭にグローバル経済は成長見通し。特にインドにおいては国策もあり半導体需要が旺盛

■ 国別GDP成長率の見通し

(G20のうち2027年GDP成長率の高い上位10か国+日本)



※ 出所:OECD

ROIC向上に向けた戦略方針

投資家面談や外部環境を踏まえ、ROIC向上に向けては「資本効率の改善」を前提に、「ソリューションの複合化」と「新規事業の創出とスケール化」をグローバルで加速して推進

中期経営計画 Hakuto 2028

事業戦略

顧客課題に応じたソリューションの複合化

- 商材・サービス・技術を柔軟に組み合わせ、顧客の課題解決に貢献
 - ・取引先から仕入れた価値、自社オリジナル価値を自ら組み合わせ、商品・製品を提供
- エレクトロニクス×ケミカルの強みを活かした新たな価値提供
 - ・エレクトロニクス&ケミカル商材に対する目利きと課題発見力・解決力をかけ合わせ、新規ソリューションを提供

新規事業の創出とスケール化

- 事業開発体制の仕組み化
 - ・新規事業の開発に特化した「ビジネスインキュベーションセンター」を新設。約40名が常駐人員として活動中

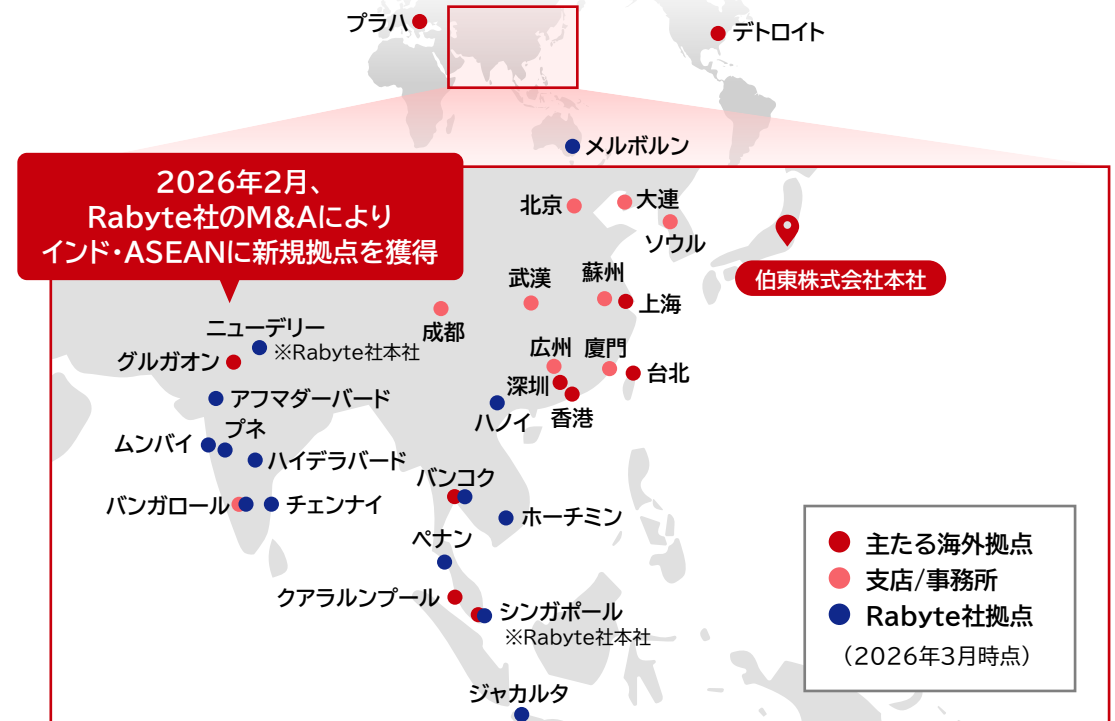
資本効率の改善(在庫の圧縮)

- ROICマネジメントの強化
 - ・サプライヤー別ROICマネジメントによるPDCAの高速化
 - ・需給管理体制の確立による在庫の適正化
- ASEAN～中華圏横断で在庫管理体制の最適化
 - ・物流の見直しと倉庫の共通化で在庫量を抑制



エリア戦略

- ・日本に加え、半導体成長の著しいインドでの事業展開を加速
- ・今後は東南アジアなどグローバルサウスでの事業成長にも注力



M&A・資本提携の推進

ソリューションの複合化と新規事業創出、エリア戦略推進においては、M&Aや資本提携も選択肢。
2024年9月にクリアライズが、2026年2月にRabyteが、M&Aによりグループイン

ターゲット領域

		製品・ソリューション	
		既存	新規
事業領域	既存	1 市場深耕	3 新製品開発
	新規	2 市場開拓	多角化

M&A実績

受託分析サービスのクリアライズを子会社化



株式取得日	2024年9月
ターゲット領域	③ 新製品開発
事業内容	化学分析、物性分析、構造分析、環境分析など、総合的な受託分析サービスを提供
取得目的	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現有事業に属さない新規事業の獲得 ・ 既存事業とのシナジー発揮
シナジーイメージ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 伯東の取引先企業に対する受託分析事業のクロスセル提案 ・ 水処理装置の販売(特に海外)

インド・シンガポールのエレクトロニクス商社、Rabyteを子会社化

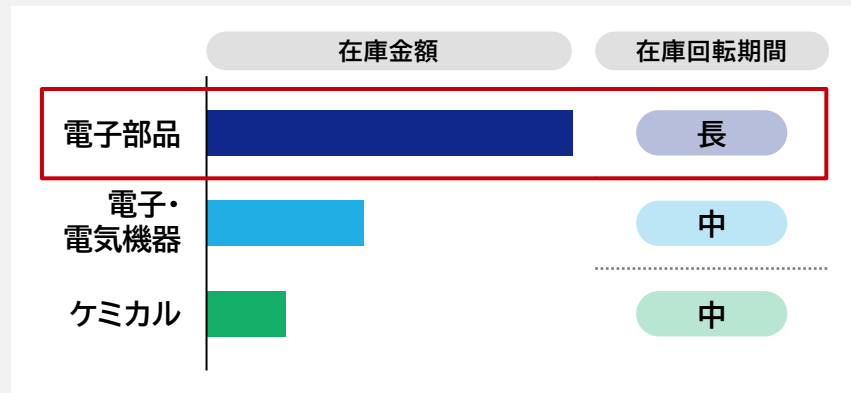


株式取得日	2026年2月
ターゲット領域	②市場開拓、①市場深耕
事業内容	電子部品・半導体製品の提供、製品開発、設計・ソリューション支援、サプライチェーン管理、検査機能を提供
取得目的	<ul style="list-style-type: none"> ・ インド、東南アジア、ANZ地域の顧客基盤拡充 ・ クロスセルによるシナジー発揮
シナジーイメージ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 両社の取扱製品群の既存顧客へのクロスセル ・ Rabyte社の設計機能及びサービスを当社既存顧客へ提供

事業別ROIC向上重要施策 ①電子部品事業(1/2)

電子部品事業は他事業部に比べ在庫が多く、また在庫回転期間も長い。加えて、製品ラインアップも多岐に渡り、ROICマネジメントが特に重要。3つのSTEPでROICマネジメントの高度化を推進

■ 事業別在庫と在庫回転期間のイメージ



■ 主な取り扱い製品



ROICマネジメント高度化ロードマップ



事業別ROIC向上重要施策 ①電子部品事業(2/2)

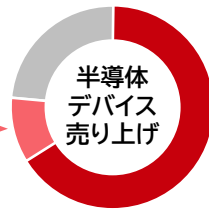
ROICマネジメント高度化においては、運転資本（主に在庫）抑制に加え、高付加価値化を追求。当社の強みを最大限に活用し、製品ポートフォリオ拡充やソリューションの複合化を加速



サプライヤーとの強固なつながり

サプライヤーごとに専任を置き、強固な関係性を構築

No.1相当の商材
10%超



No.1商材
70%

※ 24.3期実績ベース

- 当社が日本でNo.1の販売代理店という商材が多数
- 半導体デバイスでは売上げ全体の約80%がNo.1商材、No.1相当の商材



専門性の高い技術サポート

メーカーと同等程度の技術力・専門知識を備えた人材が、設計・開発からアフターサービスまで一貫した技術サポートを国内・海外で提供

電子部品事業



エンジニア比率
20%超

サプライヤーネットワーク高度化によるポートフォリオ拡充

- 既存サプライヤーとの連携強化
- 新規サプライヤーの開拓
- 重点分野(パワー半導体、ディスプレイ関連製品)のラインアップ強化

バリューチェーンにおける領域拡大と強化

- 開発・設計支援・QCサポート体制の強化
- エンジニアの増員及びスキル強化による営業力強化
- 有効な技術の獲得を目的とした外部との業務&資本連携も推進

クロスセルによる提供価値の複合化

- センサーデバイス×AI×IoTによるソリューションの複合化
- 複合的にソリューション提案できる人材と教育の拡充

事業別ROIC向上重要施策 ②電子・電気機器事業

AI向け高性能半導体の需要が高まる中、性能アップに向けては「次世代パッケージング」技術が鍵。
顧客ニーズに応じた製品ラインアップの拡充と +αソリューションの提案でLTV向上を推進

パッケージング関連装置の開発・販売



+αソリューション

半導体後工程

ダイシング

ワイヤー
ボンディング

モールドイング

検査

顧客



抱えている課題

チップレット技術

省電力化と高速化

歩留まり改善



設置・運用支援

- ・定期メンテナンス&オーバーホール
- ・機器の設置&フィールドサービス



モニタリング支援

- ・DXを活用した遠隔監視・予知保全



開発支援

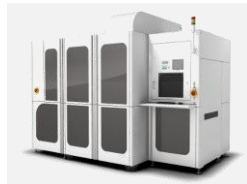
- ・電子機器の開発支援
- ・試験環境の提供
- ・製造サービス (パートナー会社)
- ・デザインサービス

半導体前工程
微細化の限界

AI/HPC向け
先端パッケージング
の需要増

中国、韓国、台湾
などアジア諸国
から強い引き合い

次世代パッケージング向け当社主力製品



ステッパー

- ・微細化に貢献



ラミネータ

- ・基板が高多層になっても歩留まりを維持



ドライクリーナー

- ・微細化に貢献
- ・歩留まり改善に貢献



自動搬送装置

- ・省人化・自動搬送による歩留まり改善

➔ 顧客ニーズや技術トレンドを踏まえ、製品ラインアップ拡充を推進

自社オリジナル製品の開発





















新規サプライヤーの開拓

M&Aによる隣接領域への展開

事業別ROIC向上重要施策 ③ケミカル事業

石油化学や紙パルプなどの既存領域は今後伸び悩み。オリジナル製品の取り扱いを拡充し、環境、電子産業、ライフサイエンスの新規領域開拓に注力

分野別見通し（当社予想）

	分野	短期見通し	中長期見通し
新規領域	 環境		
	 電子産業		
	 ライフサイエンス		
既存領域	 石油化学		
	 紙パルプ		
	 自動車		
	 化粧品		

重点取り組み施策



新規領域の開拓

- オリジナル製品の創出による、より高度な顧客ニーズ（新規領域）への対応
- 設備投資による付加価値の高いオリジナル製品取り扱い・生産体制の強化



ソリューションの複合化

- クリアライズの分析、排水技術を融合した薬品開発・排水ソリューションの提供
- AI監視システムや自動管理装置など、エレクトロニクスソリューションの提供

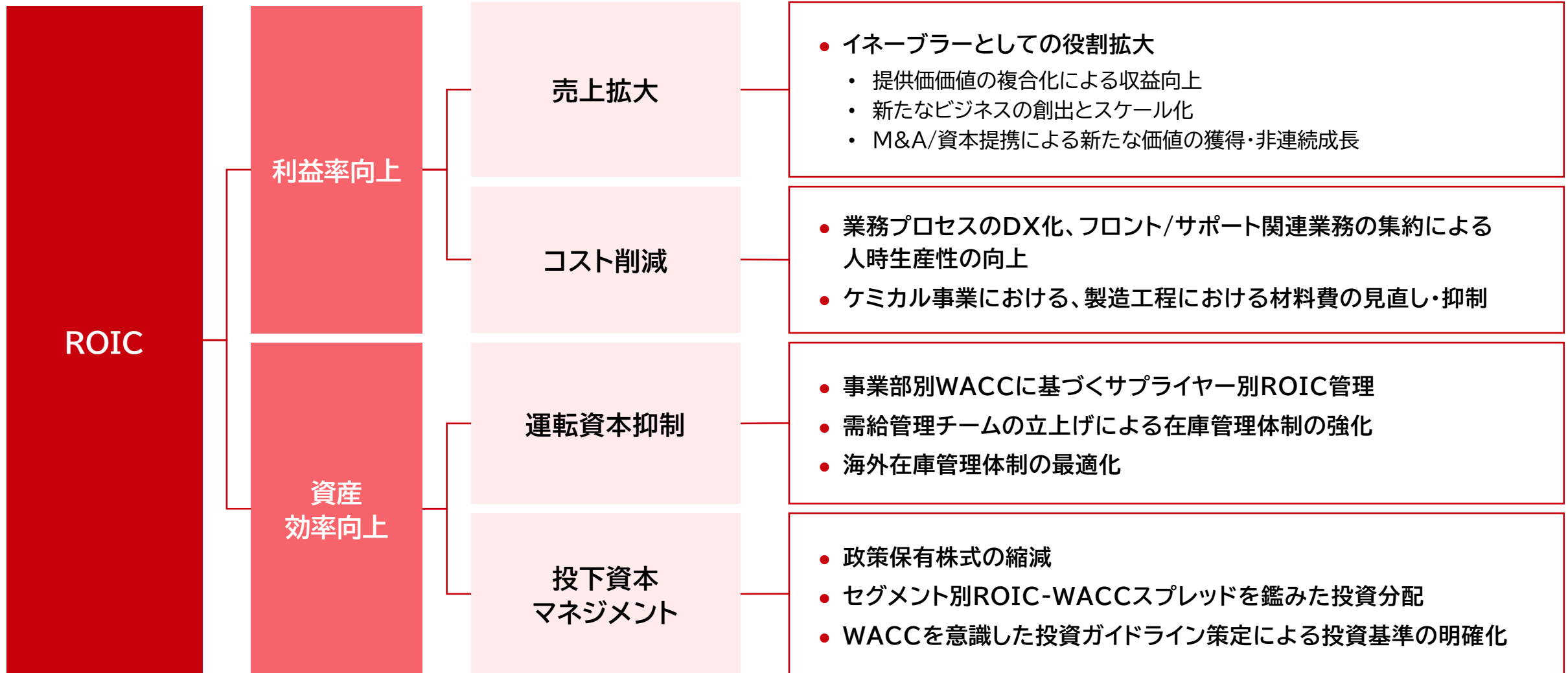


海外へのエリア拡大

- 日本・アジアで構築した環境ソリューションを、排水規制（Zero Liquid discharge）が厳しいインド市場に本格展開

ROIC向上の全体像

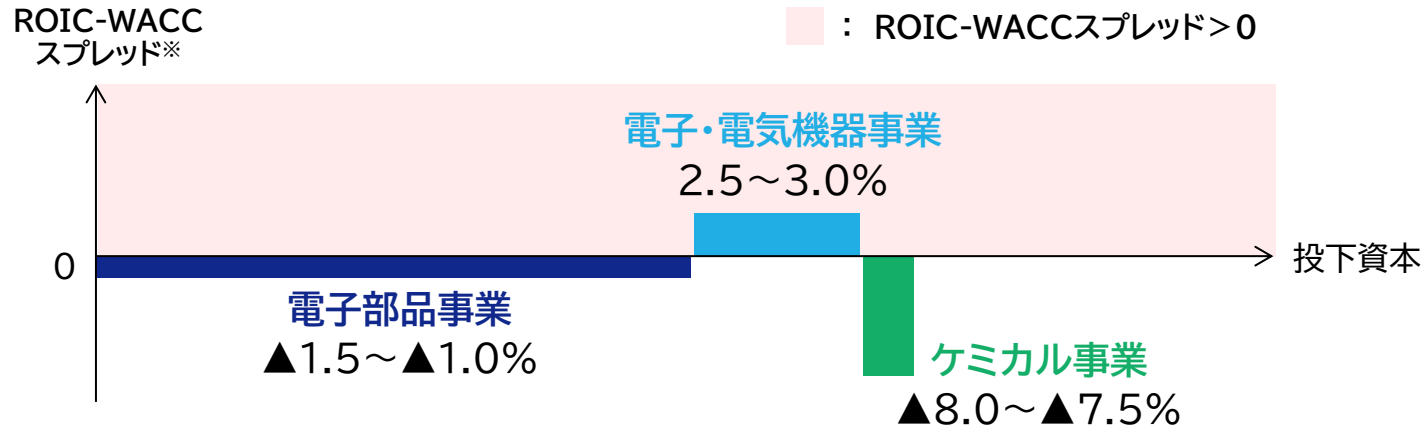
事業別重要施策を含む、ROIC向上に向けた全社取り組み



持続的な企業価値向上に向けて

ROIC-WACCスプレッド>0の場合、スプレッド×投下資本の面積が企業価値への貢献度合いを示す。電子部品/電子・電気機器事業は収益性と効率性の追求、ケミカル事業は収益性の改善を推進

25.3
実績
(為替影響除く)



電子部品事業

- ・ サプライヤー別ROICマネジメントによる収益性改善×在庫管理高度化、PDCAサイクルの高速化
- ・ M&Aによるインドでの事業拡大

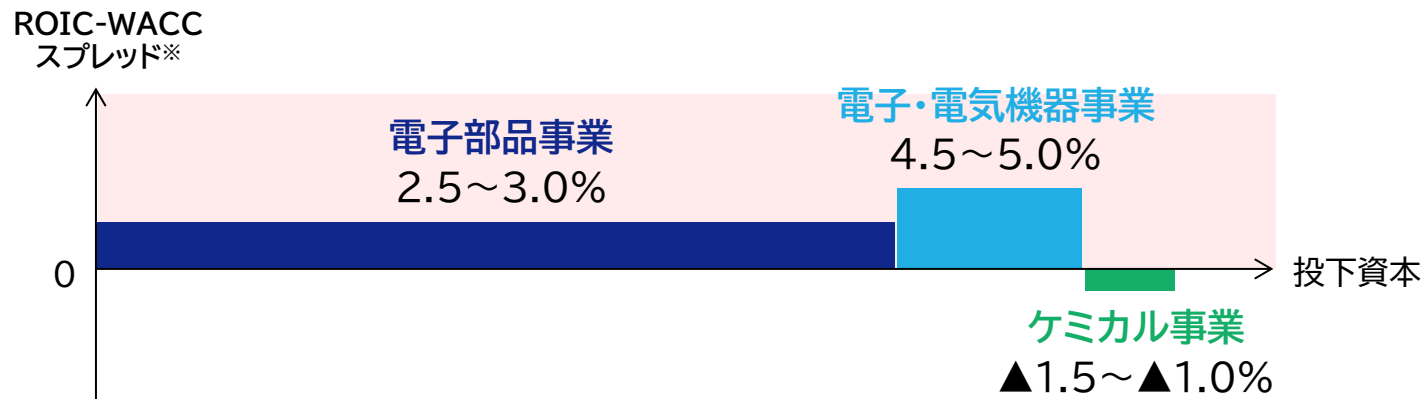
電子・電気機器事業

- ・ 自社オリジナル製品の開発
- ・ M&Aを通じた製品ラインアップ拡充
- ・ 装置+αソリューションの提案による顧客LTVの向上

ケミカル事業

- ・ 新規領域の開拓、オリジナル製品の開発による収益性改善
- ・ ソリューションの複合化、海外へのエリア拡大による事業機会拡大

29.3
計画



※ ROICは(事業別営業利益×(1-実効税率))÷投下資本(期末固定資産+期末運転資本)で算出。ただし、のれん影響を除く。WACCは事業別WACCに基づく。チャートはその他事業を除く各事業に帰属するスプレッドと投下資本に基づくため、上記事業部の合計と全社スプレッド・投下資本は一致しない

本資料にて記載されているデータ及び将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により変化する可能性があります。従いまして、本資料は記載された目標・予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。

IRに関するお問合せ先
経営企画部 Tel.03-3225-8931